

بهبود اندک عملکرد پردازنده های رایزن پس از حذف «پخش کننده گرما»

کمپانی AMD اخیراً از سه پردازنده جدید برای کامپیوترهای دسکتاپ پرده برداری کرده که با توجه به مقیاس کارایی نسبت به قیمت، بسیار ارزان قیمت بوده و پرفورمنسی در حد پردازنده های اینتل را با نصف قیمت به همراه دارد.



کمپانی AMD اخیراً از سه پردازنده جدید برای کامپیوترهای دسکتاپ پرده برداری کرده که با توجه به مقیاس کارایی نسبت به قیمت، بسیار ارزان قیمت بوده و پرفورمنسی در حد پردازنده های اینتل را با نصف قیمت به همراه دارد.

اخیراً یکی از کاربران علاقه مند به اورکلاک پردازنده AMD خود را به زیر تیغ برده و سعی کرده با انجام عملیات Delidding، راندمان آن را تا جایی ممکن افزایش دهد. این عملیات نخستین بار با ورود نسل پردازنده های Ivy Bridge رواج یافت. اینتل در این سری از سی پی یوهای خود از مواد ارزانی برای انتقال حرارت استفاده کرد که کاربران با برداشتن چسب قسمت (IHS) توزیع کننده گرما (TDP) تعبیه شده در آن، مواد بهتری را جایگزین آن می کردند و همین عامل موجب کاهش دما و بازدهی هرچه بیشتر پردازنده می شد.

گفتنی است کاربر مذکور توانست پس از نابود کردن دو پردازنده، بالاخره در CPU سوم با استفاده از تیغ اصلاح و با دقت فراوان، چسب های اتصال IHS را جدا کرده و سپس با حرارت دادن آن را به طور کامل بردارد.

کاربر مورد اشاره در قسمت بعدی، لایه ای از ایندیوم را خراشیده و مقداری فلز مایع را مستقیماً روی پردازنده قرار داده و سپس از خنک کننده (Ereboss) در آن استفاده کرده است.

در نهایت او چیپ را با کلاک 3.9 گیگاهرتز و 1.3 ولت و در دمای محیط 22 درجه مورد آزمایش قرار داد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، Delidding پردازنده های Ryzen 7 کمپانی AMD نسبت به ریسک خراب شدن آنها اصلاً عاقلانه نیست و او توانست سی پی یو مورد استفاده را تنها تا 4000 مگاهرتز اورکلاک کند که مسلماً ارزش از دست رفتن گارانتی و صدمه زدن به آن را ندارد.